

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006 年 6 月 15 日 (15.06.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/062158 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
B24B 37/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/022550
- (22) 国際出願日: 2005 年 12 月 8 日 (08.12.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2004-358595
2004 年 12 月 10 日 (10.12.2004) JP
特願 2005-001628 2005 年 1 月 6 日 (06.01.2005) JP
特願 2005-001635 2005 年 1 月 6 日 (06.01.2005) JP
特願 2005-001668 2005 年 1 月 6 日 (06.01.2005) JP
特願 2005-044027 2005 年 2 月 21 日 (21.02.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小川 一幸 (OGAWA, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 下村 哲生 (SHIMOMURA, Tetsuo)

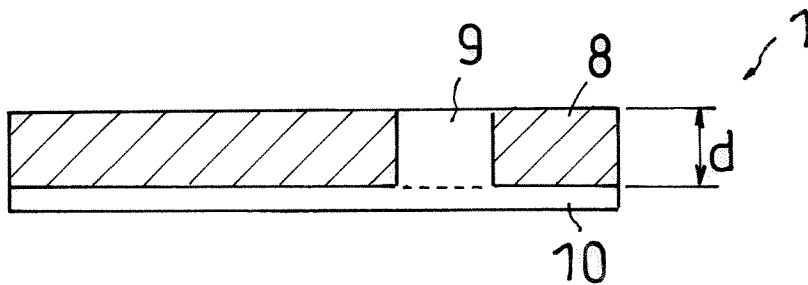
[JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡績株式会社総合研究所内 Shiga (JP). 数野 淳 (KAZUNO, Atsushi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中井 良之 (NAKAI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 渡邊 公浩 (WATANABE, Masahiro) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 山田 孝敏 (YAMADA, Takatoshi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡績株式会社総合研究所内 Shiga (JP). 中森 雅彦 (NAKAMORI, Masahiko) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目 1 番 1 号 東洋紡績株式会社総合研究所内 Shiga (JP).

- (74) 代理人: 鈴木 崇生, 外 (SUZUKI, Takao et al.); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 7 丁目 1 - 2 0 第 1 スエヒロビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド及び研磨パッドの製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a polishing pad which enables high-precision optical end point detection during polishing operation, while enabling to prevent slurry leakage from between a polishing region and a light-transmitting region even after long use. Specifically disclosed is a polishing pad which is provided with a water permeation-preventing layer (10) on one side of a polishing region (8) and a light-transmitting region (9).

The light-transmitting region and the water permeation-preventing layer are formed integrally from a same material.

(57) 要約:

研磨を行っている状態で高精度の光学終点検知を可能とし、長期間使用した場合であっても研磨領域と光透過領域との間からのスラリー漏れを防止することができる研磨パッドを提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは、研磨領域 (8) 及び光透過領域 (9) の片面に透水防止層 (10) が設けられており、かつ光透過領域と透水防止層とが同一材料により一体形成されている。



WO 2006/062158 A1



SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。